

PXP成膜装置

PXP Coater

EPC-1000



■概要

- ・ CVD法による高品質ポリパラキシリレン薄膜の成膜装置です。
- ・ 電子デバイス内の各種絶縁部材（ゲート成膜層等）や封止に最適です。

■特長

- ・ ご要望に応じて、大量の基板へのバッチ処理や大型基板への対応も可能です。
- ・ 詳細につきましては、ホームページのお問合せフォームもしくはお電話にてお気軽にお問合せ下さい。

■仕様

1. 到達圧力 : 1.0Pa以下
2. チャンバー寸法 : $\phi 800 \times 800$ mm程度
3. 気化炉 : 最高250℃
4. 分解炉 : 最高750℃
5. コールドトラップ : -80℃